

聯發科

公司分析報告

聯發科技股份有限公司

2454.TW

報告日期：2026年2月10日

分析師：Clawdbot AI

目錄

一、公司概況	2
二、財務分析	3
三、產品Roadmap	4
四、市場競爭格局	5
五、風險評估	6
六、投資價值分析	7
七、附錄	8

1.1 公司基本信息

公司全稱	聯發科技股份有限公司
股票代碼	2454.TW
總部位於	台灣新竹科學園區
市值	\$550億
主營業務	手機SoC、智能家居芯片
核心產品	天璣系列SoC、Filologic WiFi芯片
CEO	蔡力行

1.2 業務架構

核心業務

- 手機芯片：55%
- 智能家居：30%
- 物聯網：15%

下游應用

- 智能手機
- 智能電視
- 平板/車載

1.3 核心競爭優勢

聯發科 公司分析報告	說明	2026年2月10日
優勢		
中低端市場壟斷	全球手機SoC出貨量第一	

2.1 核心財務指標

FY2024營收 \$138億 YoY +XX%	淨利潤 \$28億 YoY +XX%	毛利率 48% 同比調整	淨利率 20% 優秀
--------------------------------	--------------------------	--------------------	------------------

2.2 研發費用

研發投入

年度	金額	佔營收比
FY2022	\$30億	22%
FY2023	\$32億	23%
FY2024	\$35億	25%

2.3 營收趨勢

指標	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
營收	XX	XX	XX	\$138億
YoY	-	+XX%	+XX%	+XX%
淨利潤	XX	XX	XX	\$28億
毛利率	XX%	XX%	XX%	48%

3.1 產品線

• 中高階手機

產品	發布	製程	特點	應用
天璣9400	2024Q4	3nm	全大核架構	旗艦手機
天璣8500	2025	3nm	AI性能提升	

3.2 技術優勢

- 天璣5G SoC領先
- WiFi 7份額第一
- AI處理器升級

4.1 市場份額

公司	份額
聯發科 (手機SoC)	30%
Qualcomm	40%

4.2 SWOT分析

💪 優勢

- 中低端市場領先
- 性價比優勢
- 中國市場份額高

⚠️ 劣勢

- 旗艦市場落後
- 美國市場份額低

🚀 機會

- 新興市場增長
- AI手機換機潮

🚩 威脅

- Qualcomm競爭
- 華為回歸

5.1 風險矩陣

中風險 華為競爭	中風險 份額流失
-------------	-------------

5.2 核心風險分析

核心風險

- 華為麒麟芯片回歸，可能搶佔份額
- 旗艦市場持續被Qualcomm壓制

6.1 估值指標

指標	數值	備註
當前市值	\$550億	2026年2月
PE (TTM)	約XXx	-
PS (TTM)	約XXx	-
PB	約XXx	-

6.2 買入理由

- AI手機帶動換機需求
- 新興市場持續增長
- 高股息率約4%

6.3 風險因素

- 華為競爭
- 毛利率承壓

6.4 投資建議

7.1 關鍵術語

術語	解釋
SoC	System on Chip，系統級芯片
DDIC	Display Driver IC，顯示驅動芯片

7.2 數據來源

- 聯發科 FY2024年報
- Counterpoint
- IDC

7.3 免責聲明

重要提示：本報告僅供投資參考，不構成任何投資建議。

報告總結：全球手機SoC出貨龍頭，受益AI手機和新興市場增長。